



亿晟科技
YISHENG ELECTRONICS

产品承认书

客户名称: _____

产品名称: 智能安卓主板

产品型号: YS-FA133

承认书版本: V1.5

生效日期: 2024-02-28

方案提供商	客户确认
拟制:	合格 ☐ 不合格 ☐
审核:	验证:
批准:	批准:

（双方确认承认书合格后必须签字盖章）



深圳市亿晟科技有限公司

深圳：深圳市宝安区立新湖高新产业园研发中心6楼
广州：广州市番禺区兴南大道565号江润大厦318室
电话/传真：0755-2738 3670 邮箱：lisiping@yishengtc.com

目 录

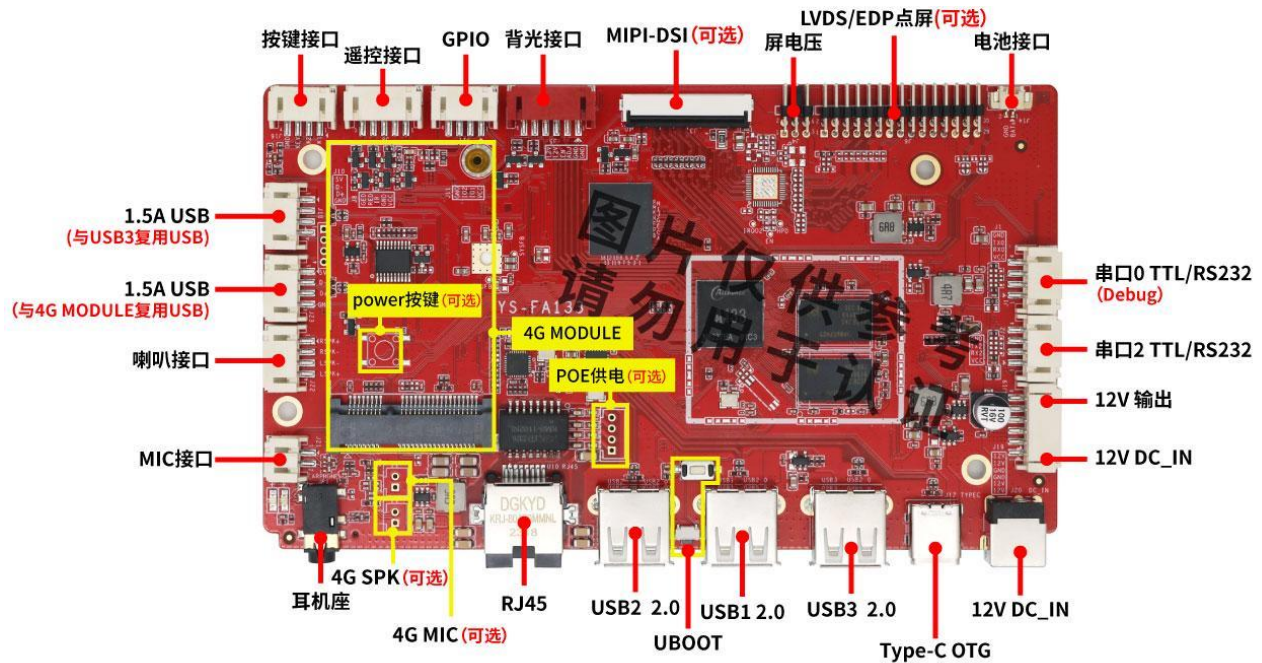
第一章 产品概述	1
1.1 产品外观及尺寸	1
1.2 产品详细参数	2
1.3 接口详细说明	3
第二章 产品使用	7
2.1 外设支持	7
2.2 组装示意图	7
2.3 组装使用注意事项	8
2.4 系统使用说明	8
2.4.1 安卓系统界面说明	8
2.4.2 网络连接说明	10
2.4.3 存储信息查看	11
2.4.4 通知栏与导航栏的设置	12
第三章 接口定义	13
第四章 电气性能	20
附录 1 主板背面图	20
附录 2 主板详细尺寸图	22

第一章 产品概述

YS-FA133

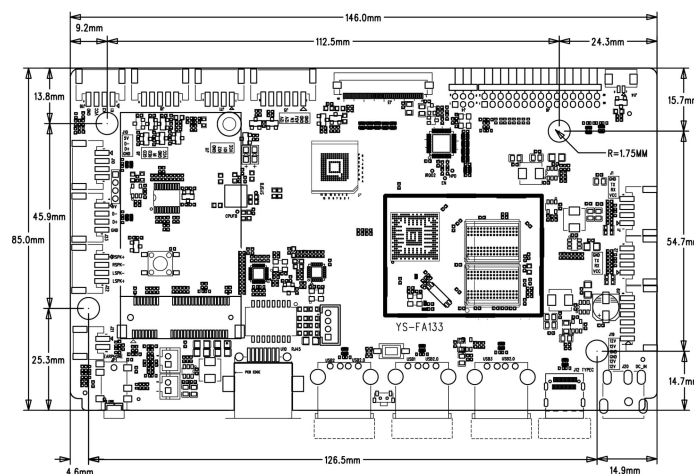
1.1 产品外观及尺寸

正面接口图



注：此板卡图片仅供参考，由于产品在不断维护，具体出货主板以实物为准

外形尺寸图

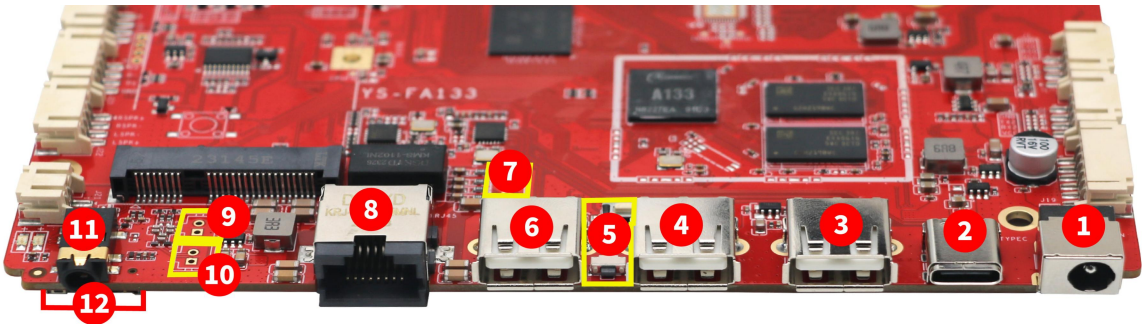
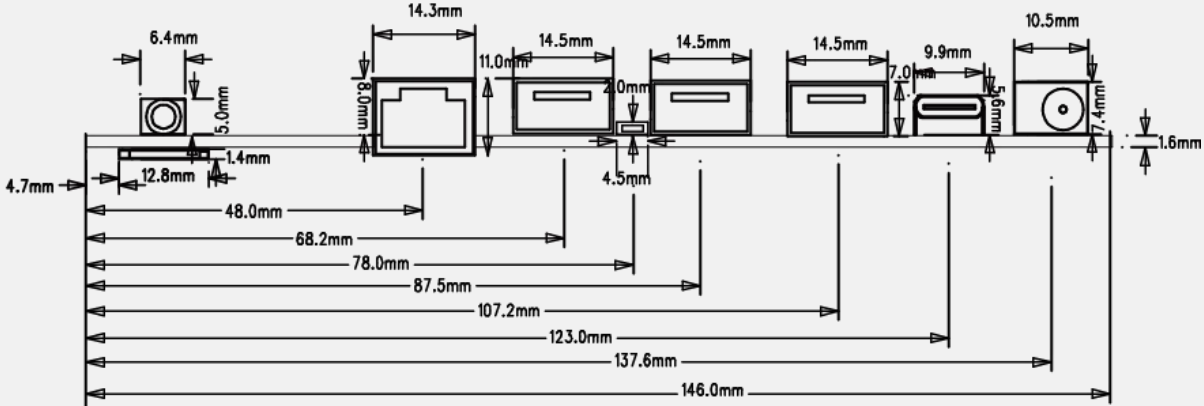


*PCBA 长度: 146mm *PCBA 宽度: 85mm *PCBA 高度: 12mm *PCBA 螺丝孔直径: 3.4mm x4

1.2 产品详细参数

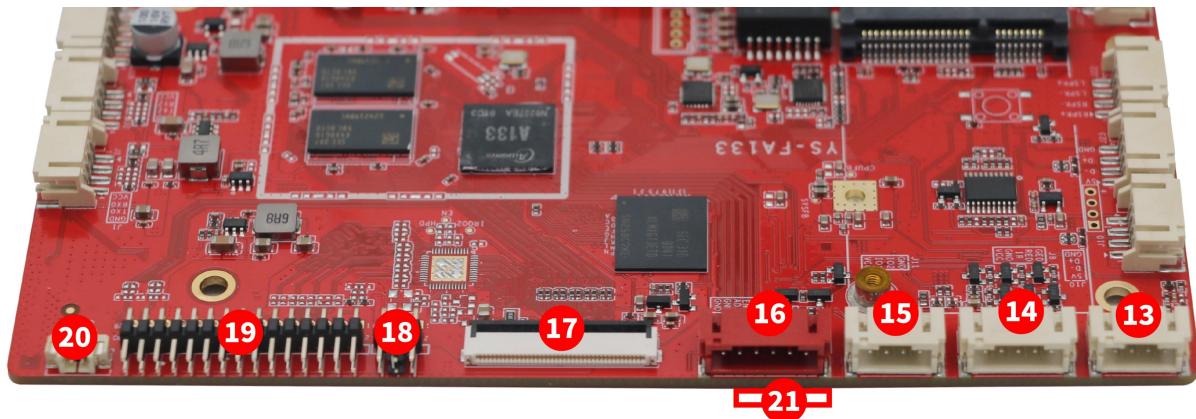
				
全志 A133 四核高性能芯片	默认安卓10.0系统	1*Type-C接口 4*USB2.0 (1*可选)	支持百兆以太网 WIFI 2.4、BT-4.2、4G LTE	支持LVDS/EDP MIPI点屏
详细参数				
CPU	四核 32 位 Cortex-A53，主频最高 1.5GHz			
GPU	IMG PowerVR GE8300			
存储	DDR 默认支持 1G/2G EMMC 默认 8G, 最高可扩展到 128G			
多媒体	H. 265/VP9/H. 264 (H. 265/H. 264) 最大性能可达 4K@30fps			
	H. 264 视频解码至 1080p@60fps			
显示	支持 LVDS、MIPI、EDP 单屏显示输出			
外围接口	支持 100M/10M 自适应以太网			
	支持 WIFI 2.4、BT-4.2			
	4 个 USB 2.0 (其中 1 路与 4G MODULE 接口二选一使用)，1 个 Type-C OTG			
	2 个 TTL/RS232 串口 (默认作为 TTL 串口，其中一个为 Debug 串口)			
	1 个遥控接口			
	3 个按键接口			
	1 个 I2C 触摸屏接口			
	2 个通用 GPIO 口			
	1 个双八 LVDS 点屏接口，最高支持 1920X1080 输出(可选)			
	1 个 EDP 点屏接口，最高支持 1920X1080 输出(可选)			
	1 个 MIPI-DSI-40PIN-FPC 点屏接口，最高支持 1200X1920 输出(可选)			
	1 路屏背光+亮度调节接口			
	1 个 MIPI-CSI-30PIN-BTB			
	1 个 POE 供电 (可选)			
	支持喇叭接口，最高支持一个 8Ω5W 双声道喇叭输出			
	1 路本地 MIC 接口和 1 路本地喇叭，1 路 3.5mm 耳机接口，1 路 4G MIC (可选)，1 路 4G SPK (可选)，4G/3G MINI_PCIE (可选)、SIM 卡座(可选)			

1.3 接口详细说明

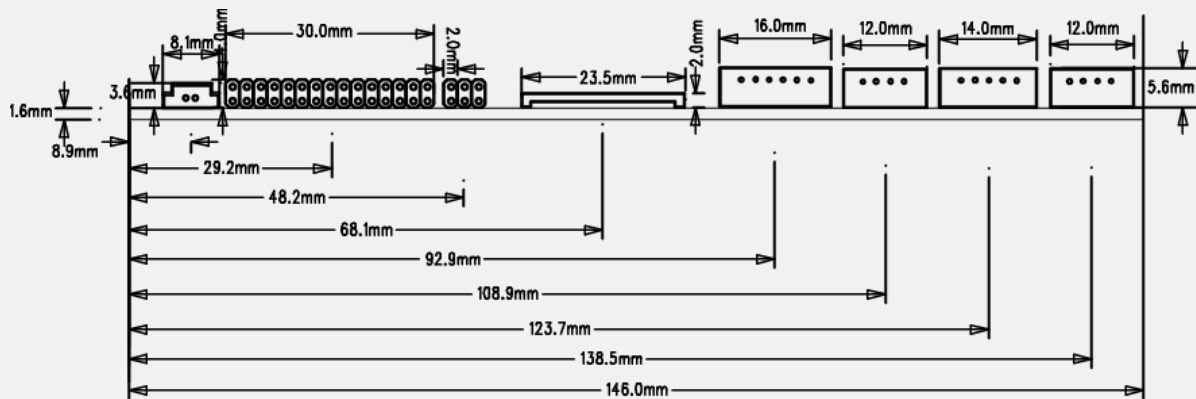
正面接口		
产品图片		
尺寸图		
序号	接口	说明
1	+12V DC_IN	外径 6.0mm、内径 2.0mm DC 座，推荐 12V/2A DC 输入
2	Type-C OTG	标准 USB2.0 Type-C 接口，固定 USB OTG 模式、可设置为 USB Host 模式，限流 1.5A
3	USB3 2.0	标准 USB2.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.5A
4	USB1 2.0	标准 USB2.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.5A
5	UBOOT	强制刷机按键
6	USB2 2.0	标准 USB2.0 Type-A 接口，固定 Host 模式、限流 1.5A
7	POE 供电 (可选)	4pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，接 POE 转接板的输入端
8	RJ45	10/100M 以太网接口，可扩展 POE 供电
9	4G MIC	2Pin*2.0mm间距wafer连接器，接MIC，当进行 4G语音通话时实现音频输入，默认不贴
10	4G SPK	2pin*2.0mm间距wafer连接器，接单声道喇叭，当进行 4G通话时输出声音，接口默认不贴座子
11	耳机座	标准 3.5mm 4 节耳机耳机座，CTIA（美标）标准，带MIC功能
12	SIM卡座 (背面接口)	nano SIM卡座，带卡拖，可接入不同的运营商Nano SIM卡，同时接入 4G模块、天线后可实现 4G功能

上侧接口

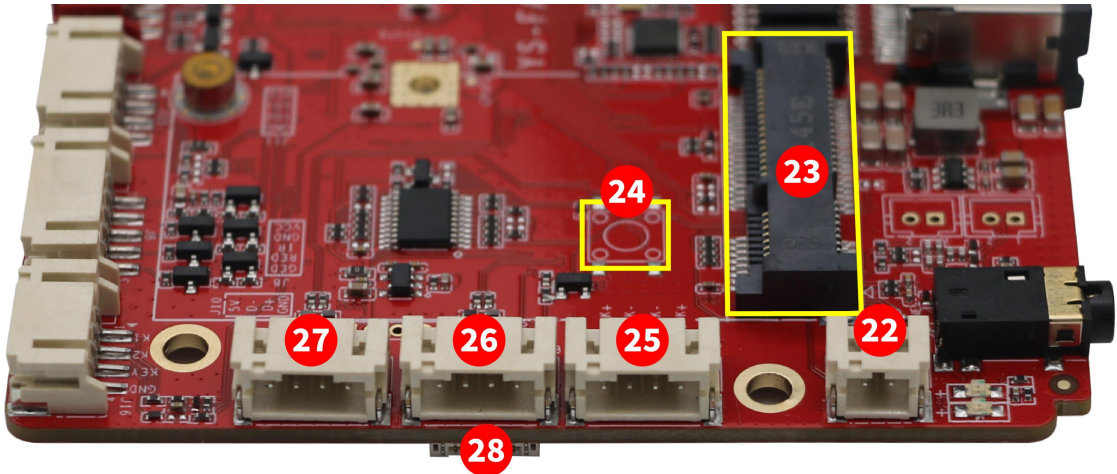
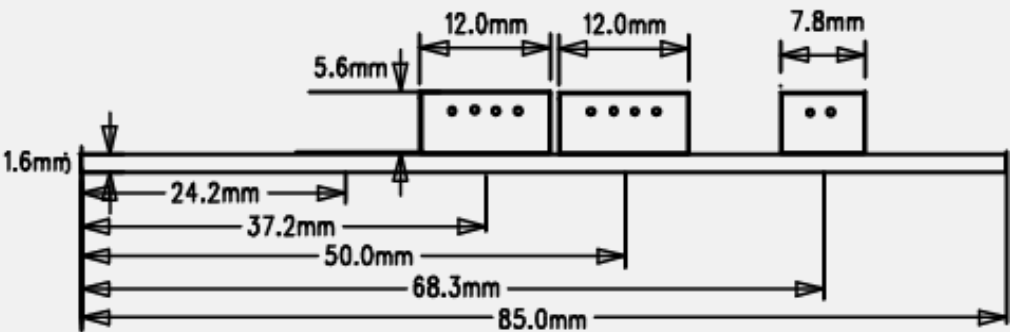
产品图片

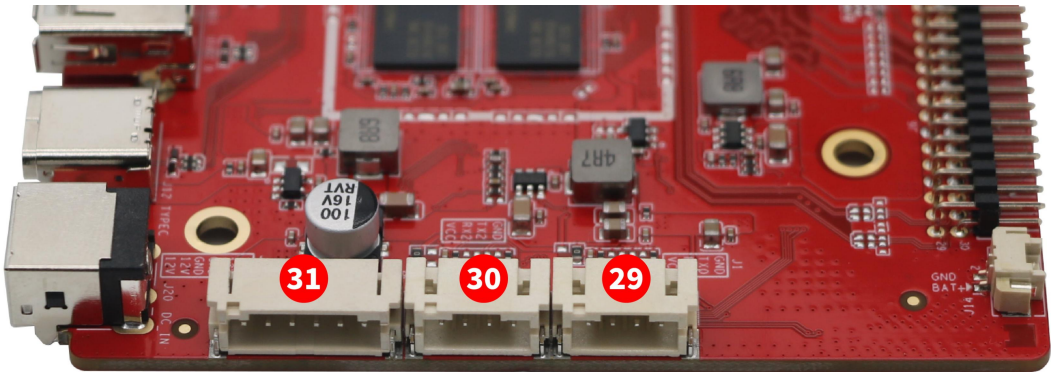
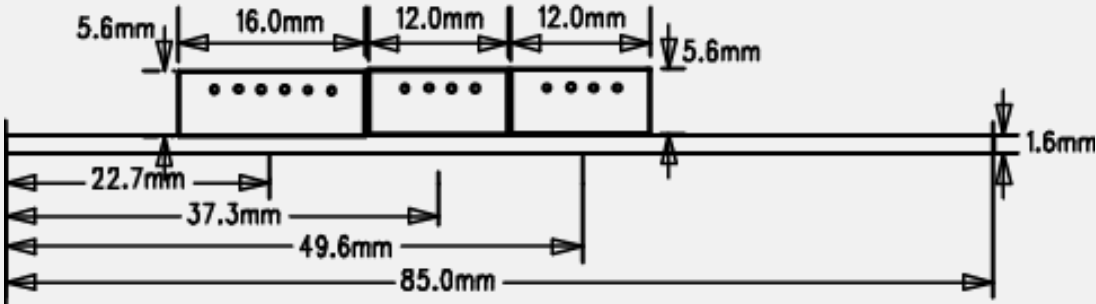


尺寸图



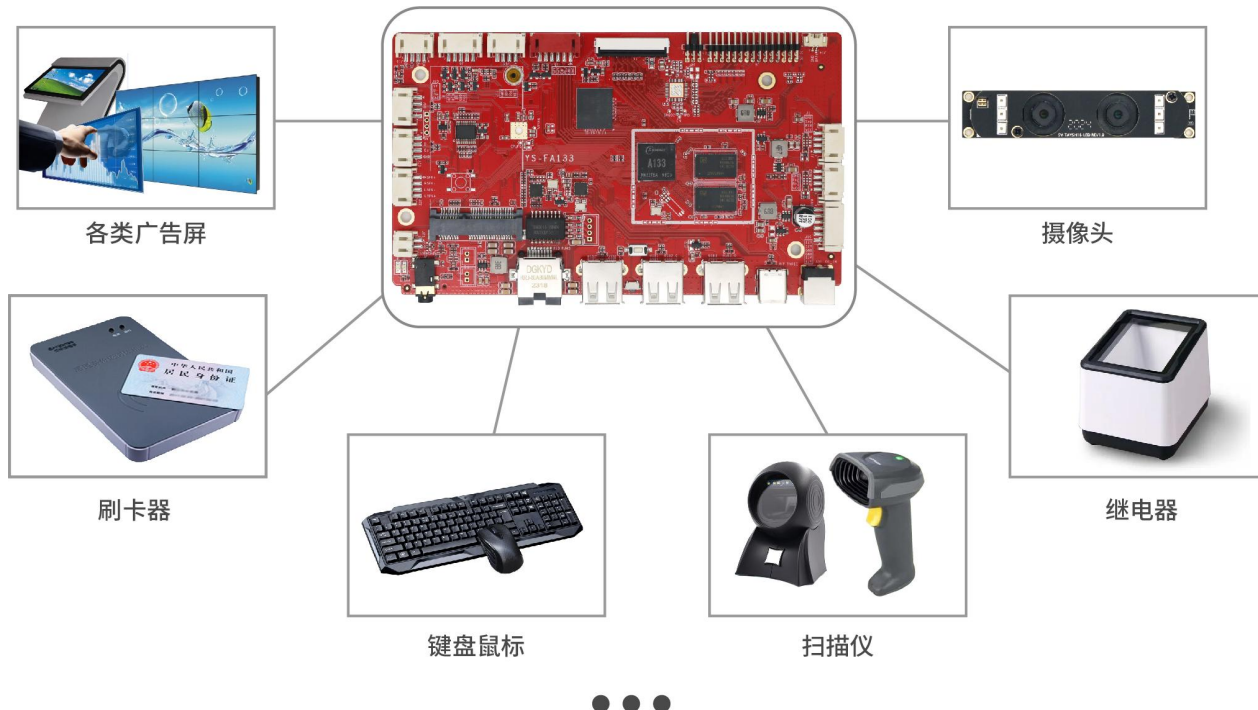
序号	接口	说明
13	按键接口	4Pin*2.0mm间距wafer连接器，默认功能：PWR开关机/K1 音量+/K2 音量-（K1/K2 功能可配置）
14	遥控接口	5Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，可接两个 LED 灯（LED 灯共阴），一个红外接收头，用遥控器对主板进行遥控测试
15	GPIO	4Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器，预留 GPIO 接口，可配置 IN/OUT，电源域 3.3V
16	背光接口	6Pin*2.0mm间距wafer连接器，主屏背光接口，支持屏背光使能开关、亮度调节
17	MIPI DSI (可选)	40Pin*0.5mm 间距 ZIF 连接器，MIPI 点屏接口，最高支持 1200*1920 分辨率
18	屏电压	6Pin*2.0mm 间距DIP连接器，LVDS屏电压选择接口，3.3V/5V/12V可选，默认 5V
19	LVDS/EDP点屏 (可选)	30Pin*2.0mm间距DIP连接器，硬件可以选择为LVDS或者EDP点屏，最高支持 1920*1080 分辨率，LVDS、EDP、MIPI三种点屏方式只能同选择一种显示
20	电池接口	2Pin*1.25mm间距wafer连接器，RTC电池接口，默认电压 3.3V
21	MIPI_CSI (背面接口)	30Pin*0.4mm 间距 ZIF 连接器，BTB 母座，接 MIPI 摄像头

左侧接口		
产品图片		
尺寸图		
序号	接口	说明
22	MIC 接口	2Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器, MIC 音频输入接口
23	4G 模块	MINI-PCIE 座 52Pin 0.6PH, 接 4G 模块
24	Power 按键(可选)	预留开关机按键
25	喇叭接口	4Pin*2.0mm 间距 wafer 连接器, 功放输出接口, 双声道, 最大可接两个 8Ω 5W 喇叭
26	1.5A USB (可选)	4Ppin*2.0mm 间距 wafer 连接器, 固定 Host 模式, USB 限流 1.5A, 这个接口跟 4G 板载的 4G MODULE 的 USB 复用, 两个接口二选一使用
27	1.5A USB(可选)	4Ppin*2.0mm 间距 wafer 连接器, 固定 Host 模式, USB 限流 1.5A, 这个接口跟正面接口序号为 3 的 USB 接口为复用 USB, 两个接口二选一使用
28	I2C 触摸屏 (背面接口)	10Pin*0.5mm ZIF 连接器, 预留 IIC 接口, 支持中断/复位, 电源域 3.3V, 默认调试了 驱动为 GT9XX 的 IIC 触摸屏

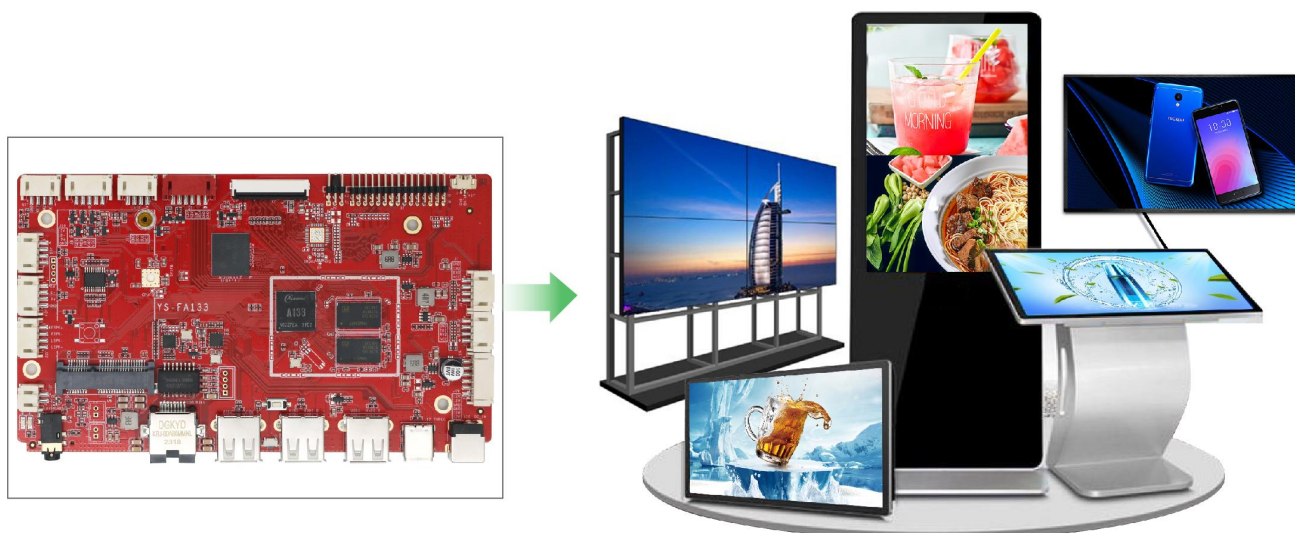
右侧接口		
产品图片		
尺寸图		
序号	接口	说明
29	串口 0	4Pin*2.0mm间距wafer连接器，默认TTL串口，可选配TTL/RS232 串口，默认Debug模式，用于调试、日志打印，可配置为通用TTL串口接外设使用，电源域 3.3V
30	串口 2	4Pin*2.0mm间距wafer连接器，默认TTL串口，可选配TTL/RS232 串口，电源域 3.3V
31	12V OUT&IN 供电	6Pin*2.0mm间距wafer连接器，12V输入输出供电接口，推荐 DC输入使用 12V/2A

第二章 产品使用

2.1 外设支持



2.2 组装示意图



2.3 组装使用注意事项

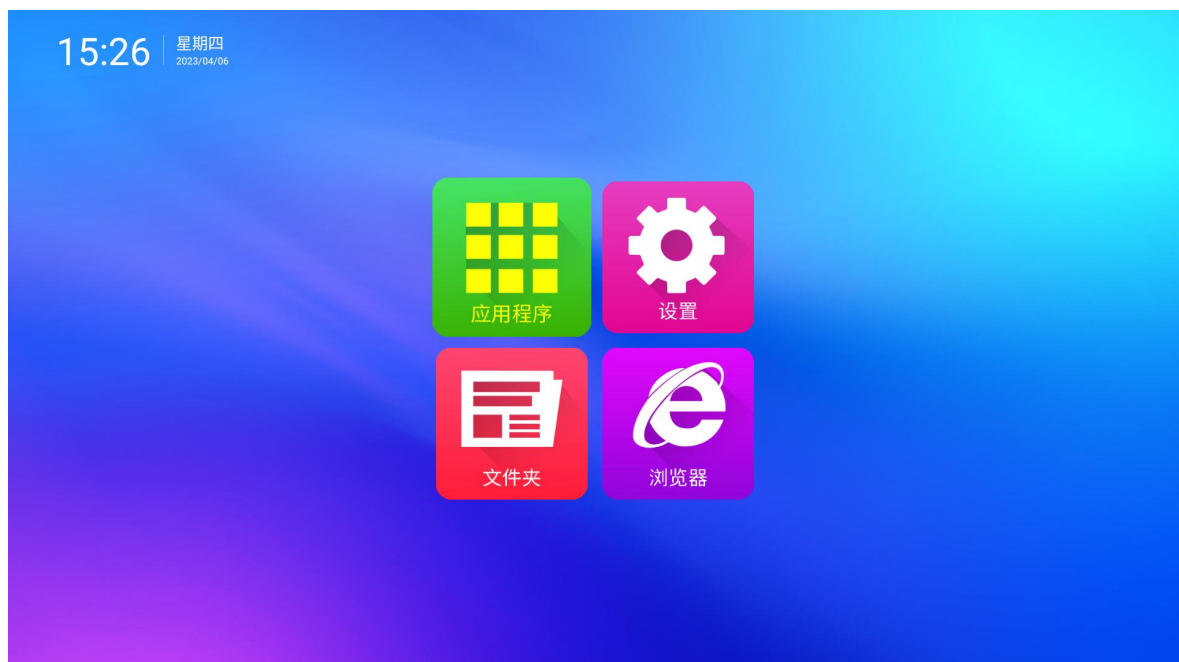
在组装使用过程中，请注意下面（且不限于）问题点。

1. 相对湿度 $\leq 85\%$
2. 存储温度： -30°C 至 $+70^{\circ}\text{C}$
3. 使用温度： -15°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$
4. 整机装配过程中请注意不要带电操作接线等，避免裸板与外设短路等问题。
5. 整机装配和运输过程中注意防静电处理，需要配带静电手环（套）等静电防护工具。
6. 整机装配时，可下装或侧装，但不要使板子变形或扭曲，勿受重压。
7. 各端子的接线位置保留合适的距离，以免安装时导致挤压端子。
8. 本板和配套的模块板之间的连接线不宜过长，否则可能会影响图像质量。
9. 整机内部应合理布线，各连接线尽可能不要直接从 PCB 板上穿越。
10. 为整机达到更好的 EMC 效果，建议主板和屏之间的屏线采用屏蔽线。
11. 安装所接外设规格需与我司确认，包括但不限于，外设限压、限流、时序、电源域等

2.4 系统使用说明

2.4.1 安卓系统界面说明

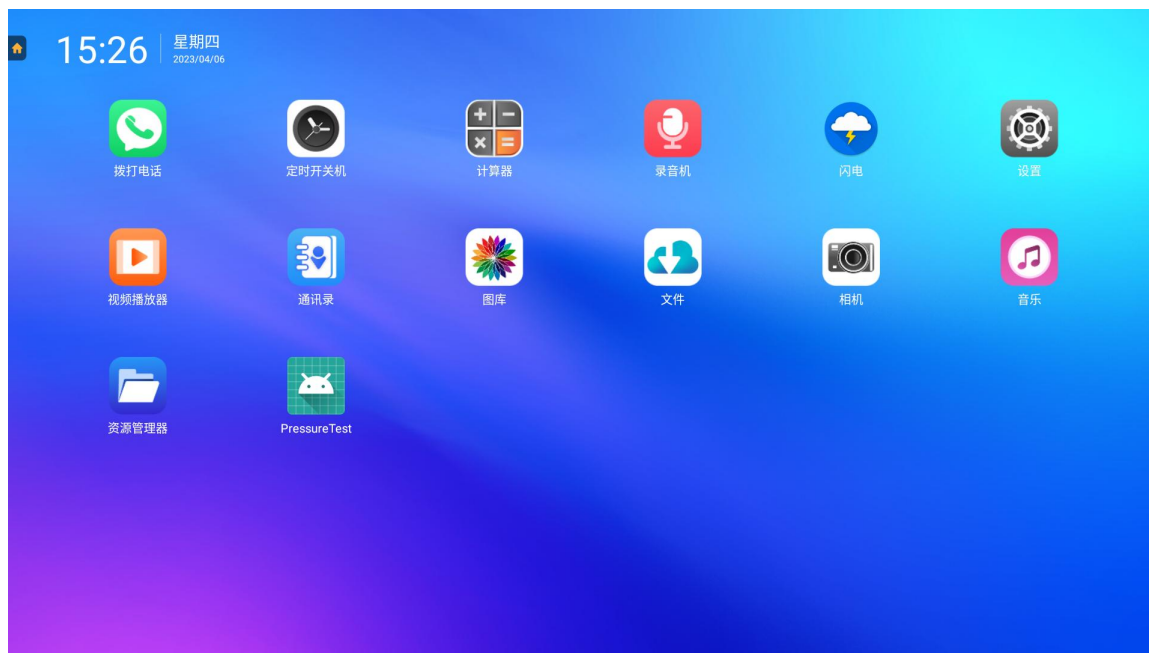
安卓系统主菜单界面分为四大类：应用程序、设置、文件夹以及浏览器



主页界面

(1) 应用程序界面

应用程序界面有：定时开关机、视频播放器、设置、图库、文件、相机、音乐、资源管理器、浏览器、HDMI-IN等应用。



应用程序界面

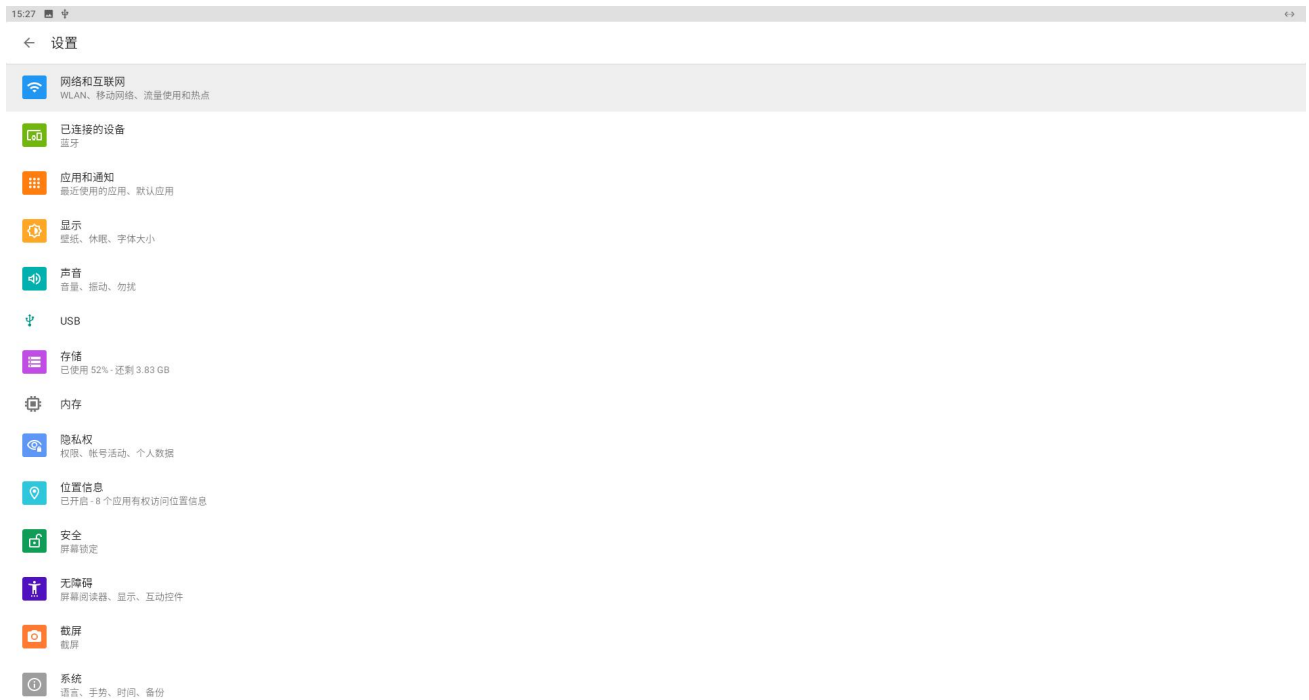
(2) 文件管理界面



文件管理界面

(3) 设置菜单界面

支持无线网络以及设备显示声音的设置，也可查看设备所安装的程序应用，以及存储内存情况等

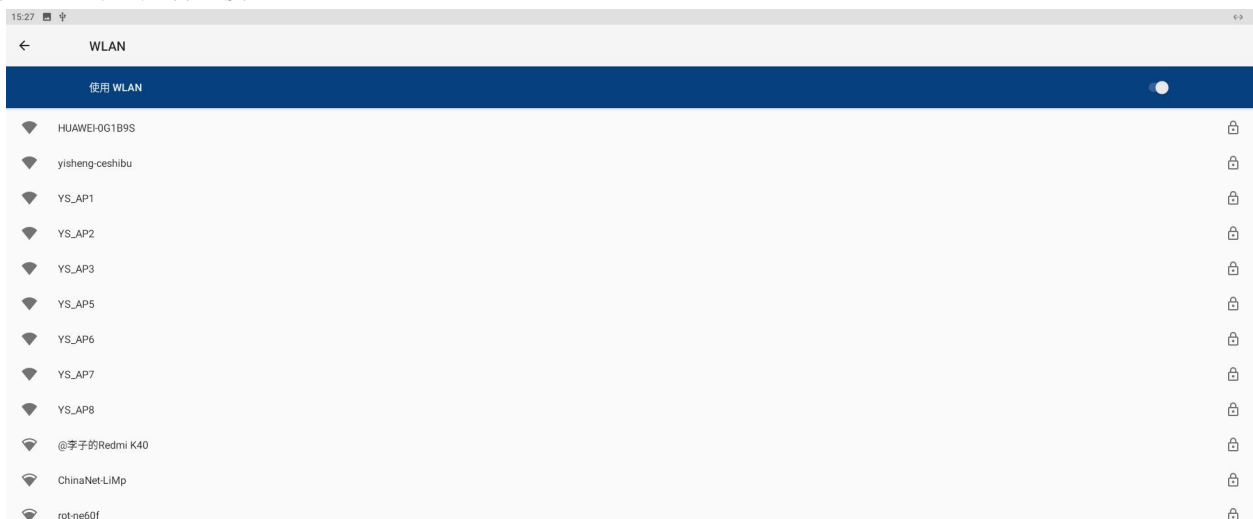


系统设置界面

2.4.2 网络连接说明

（1）WIFI 网络信号连接

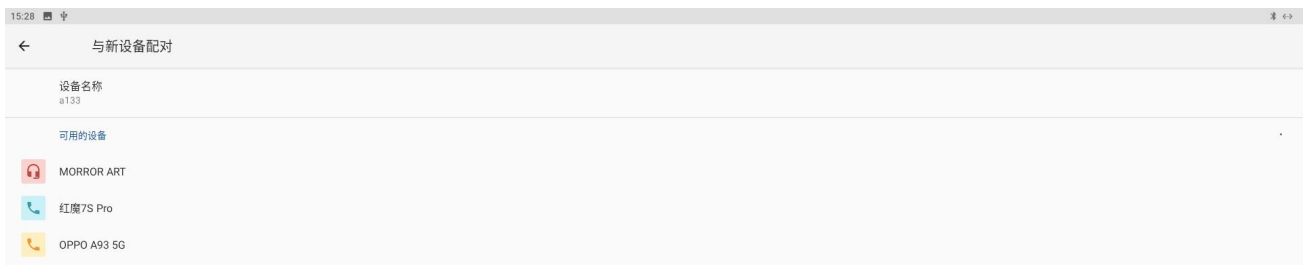
进入“设置-网络和互联网-WLAN”界面将 WIFI 开关打开，如下图;选择需要连接的 WIFI 信号，并输入相应的密码，即可成功连接。



WIFI 设置界面

（2）蓝牙信号连接

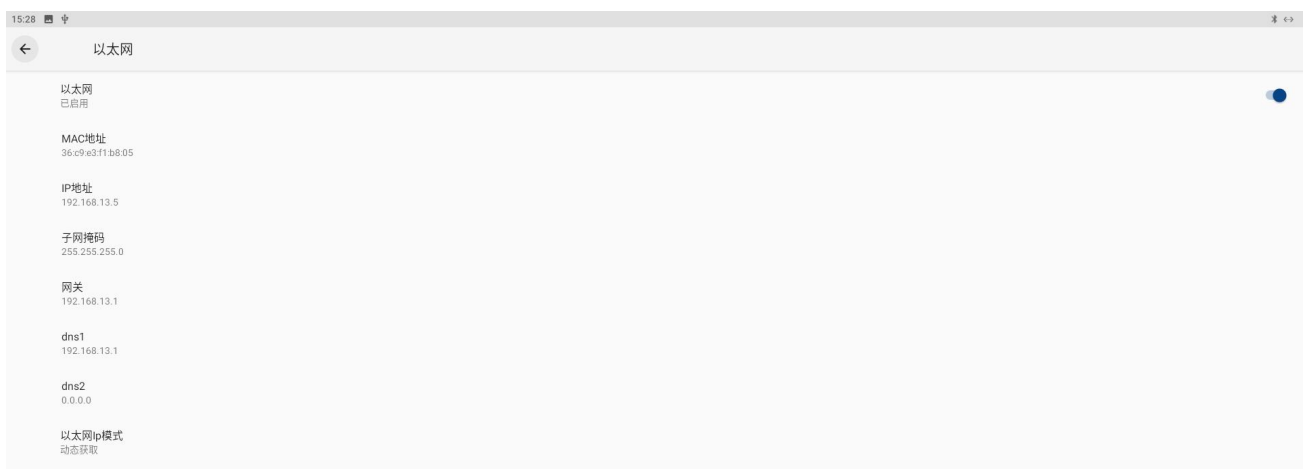
在“设置-已连接的设备-与新设备配对”界面，即可搜索到蓝牙设备，如下图，找到需要配对的蓝牙设备点击配对即可。



蓝牙界面

(3) 以太网连接

进入“设置-网络和互联网-以太网”界面，如下图页面，打开以太网开关，即可插入网线后自动连接上以太网，可在如图界面查看到 IP 地址，以太网 MAC 地址等信息



以太网设置界面

注意：

- WIFI 以及蓝牙的使用必须要在 WIFI 天线座子处接好 WIFI 天线
- WIFI 信号的可用性和覆盖范围由信号数量、天线性能及外部环境而定。
- 以太网的 MAC 地址为本系统唯一永久有效的设备 ID。

所有安卓设备网络优先级顺序为：

- 1、ETH 以太网网络
- 2、WIFI 无线网络
- 3、3G/4G/5G 移动网络

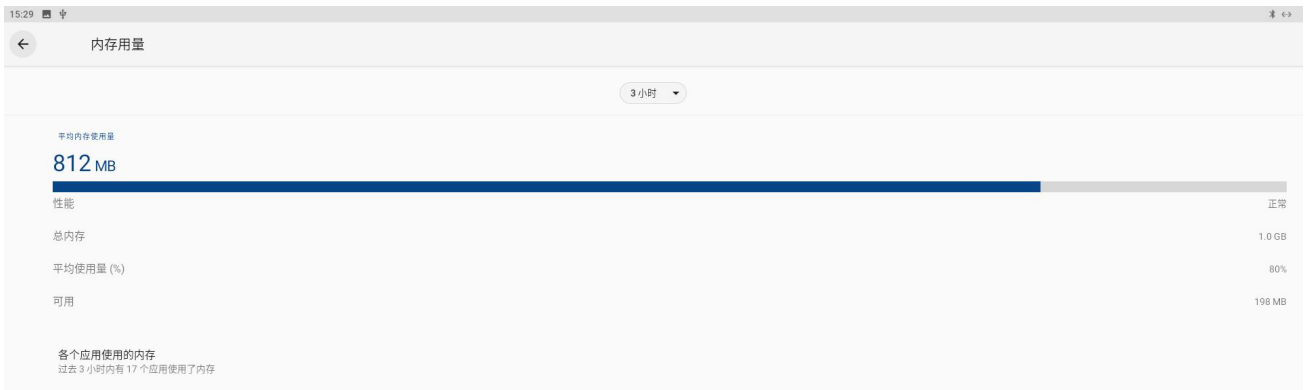
2.4.3 存储信息查看

在设置中，选择“存储”，进入下图界面，显示内部存储空间的存储信息。显示 4.17GB 为板卡已经使用的容量，显示“共 8G”为硬件总存储容量，列表会显示每个应用用去的存储空间。



查看存储界面

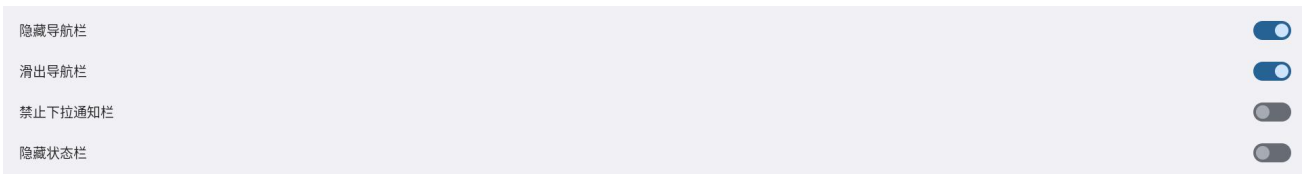
在设置中，选择“内存”，进入下图界面，显示内部存储空间的存储信息。显示 812MB 为板卡已经使用的用量，显示“共 1GB”为硬件总内存，列表会显示每个应用用去的存储空间。



查看内存界面

2.4.4 通知栏与导航栏的设置

在“设置-显示”中，选择“显示”：勾选“隐藏导航栏”，导航栏会隐藏；勾选“滑出导航栏”，鼠标从底下向上滑动可滑出导航栏，无操作 5 秒后导航栏消失。勾选“禁止下拉通知栏”，不能下拉通知栏；勾选隐藏状态栏可隐藏界面上方显示时间等状态的状态栏，隐藏状态栏后通知栏默认禁止下拉。



通知栏与导航栏显示设置界面



导航栏

注意：

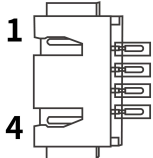
选择“滑出导航栏”前提下需要选择“隐藏导航栏”；隐藏状态栏后，通知栏也默认被强制隐藏

第三章 接口定义

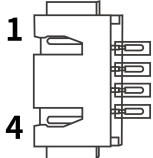
J21 (2PIN/2.0) MIC 接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	MICN-	麦克正极
	2	MICP+	麦克负极

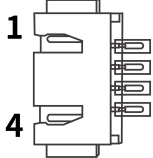
J22 (4PIN/2.0) 喇叭接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	RSPK+	右声道+
	2	RSPK-	右声道-
	3	LSPK-	左声道-
	4	LSPK+	左声道+

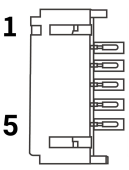
J23、J10 (4PIN/2.0) 1.5A USB 接口 (弯插) (J10、J23 可选)

外观	脚序号	定义	描述
	1	+5V	供电
	2	D-	DM
	3	D+	DP
	4	GND	地

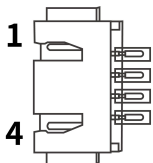
J16 (4PIN/2.0) 按键接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	K1	预留按键 K1
	2	K2	预留按键 K2
	3	PWR	关机/开机按键
	4	GND	地

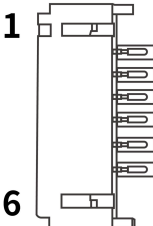
J8 (5PIN/2.0) 遥控接口 (弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	3.3V 供电
	2	GND	地
	3	IR	遥控
	4	RED	红色指示灯
	5	GED	绿色指示灯

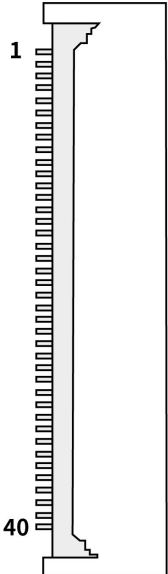
J11 (6PIN/2.0) GPIO 接口 (弯插) (电源域 3.3V)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	供电
	2	GPIO1	I/O 接口 1
	3	GPIO2	I/O 接口 2
	4	GND	地

J5 (6PIN/2.0) 背光接口 (弯插)

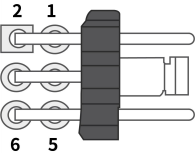
外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	GND	地
	3	ADJ	背光亮度调节
	4	EN	背光开/关控制
	5	+12V	屏背光供电
	6	+12V	屏背光供电

J3 (40PIN/0.5mm) MIPI_DSI 接口 (FPC 座) (可选)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VDD1V8	+1.8V 供电
	2	VDD3V3	+3.3V 供电
	3	VDD3V3	+3.3V 供电
	4	NC	空脚
	5	RESET	复位
	6	NC	空脚
	7	GND	地
	8	MIPI_D0-	MIPI 信号
	9	MIPI_D0+	MIPI 信号
	10	GND	地
	11	MIPI_D1-	MIPI 信号
	12	MIPI_D1+	MIPI 信号
	13	GND	地
	14	MIPI_CLK-	MIPI 信号
	15	MIPI_CLK+	MIPI 信号
	16	GND	地
	17	MIPI_D2-	MIPI 信号
	18	MIPI_D2+	MIPI 信号

	19	GND	地
	20	MIPI_D3-	MIPI 信号
	21	MIPI_D3+	MIPI 信号
	22	GND	地
	23	NC	空脚
	24	NC	空脚
	25	GND	地
	26	NC	空脚
	27	NC	空脚
	28	NC	空脚
	29	NC	空脚
	30	GND	地
	31-32	LEDK	背光供电
	33	NC	空脚
	34	NC	空脚
	35	NC	空脚
	36	NC	空脚
	37	NC	空脚
	38	NC	空脚
	39-40	LEDA	背光供电

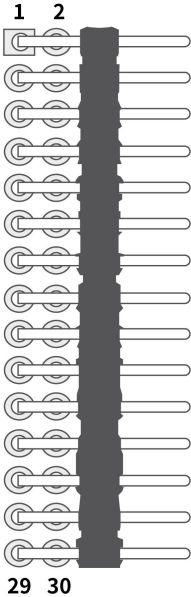
J4(6PIN/2.0) 屏电压跳冒（杜邦针）

外观	脚序号	定义	描述
	1	12V	12V 供电
	2	VCC_LCD	屏电压连接端口
	3	5V	5V 供电
	4	VCC_LCD	屏电压连接端口
	5	3.3V	3.3V 供电
	6	VCC_LCD	屏电压连接端口

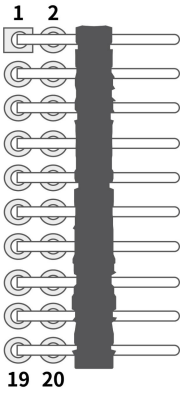
注：LVDS 屏幕用跳线帽来进行屏电源的选择，将 3.3V 与 VCC_LCD 连通，则屏电压为 3.3V。

J6（30PIN/2.0）LVDS 点屏（杜邦针）（可选）

外观	脚序号	定义	描述
	1	PWR	供电
	2	PWR	供电
	3	PWR	供电
	4	GND	地
	5	GND	地

	6	GND	地
	7	D0N	LVDS 信号
	8	D0P	LVDS 信号
	9	D1N	LVDS 信号
	10	D1P	LVDS 信号
	11	D2N	LVDS 信号
	12	D2P	LVDS 信号
	13	GND	地
	14	GND	地
	15	CLK0N	LVDS 信号
	16	CLK0P	LVDS 信号
	17	D3N	LVDS 信号
	18	D3P	LVDS 信号
	19	D5N	LVDS 信号
	20	D5P	LVDS 信号
	21	D6N	LVDS 信号
	22	D6P	LVDS 信号
	23	D7N	LVDS 信号
	24	D7P	LVDS 信号
	25	GND	地
	26	GND	地
	27	CLK1N	LVDS 信号
	28	CLK1P	LVDS 信号
	29	D8N	LVDS 信号
	30	D8P	LVDS 信号

J6 (20PIN/2.0) EDP 点屏 (杜邦针) (可选)

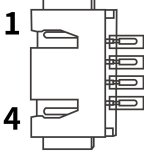
外观	脚序号	定义	描述
	1	PWR	供电
	2	PWR	供电
	3	GND	地
	4	GND	地
	5	TX0N	EDP 信号
	6	TX0P	EDP 信号
	7	TX1N	EDP 信号
	8	TX1P	EDP 信号
	9	TX2N	EDP 信号
	10	TX2P	EDP 信号
	11	TX3N	EDP 信号
	12	TX3P	EDP 信号

	13	GND	地
	14	GND	地
	15	AUXN	EDP 信号
	16	AUXP	EDP 信号
	17	GND	地
	18	GND	地
	19	GND	地
	20	HPD	插拔检测

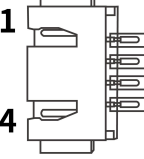
J14 (2PIN/1.25) 电池接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	+	电池正极
	2	-	电池负极

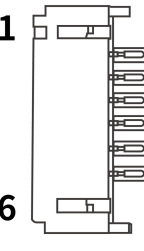
J1 (4PIN/2.0) 串口 0(弯插) (Debug 串口, 默认 TTL, 可选 RS232, 电源域 3.3V)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	供电 3.3V (5V 可选)
	2	RX0	接收 0
	3	TX0	发送 0
	4	GND	地

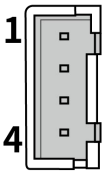
J2 (4PIN/2.0) 串口 2(弯插) (默认 TTL, 可选 RS232, 电源域 3.3V)

外观	脚序号	定义	描述
	1	VCC	供电 5V (3.3V 可选)
	2	RX2	接收 2
	3	TX2	发送 2
	4	GND	地

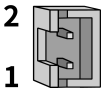
J19 (6PIN/2.0) 供电接口(弯插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	12V	12V 输入/输出
	2	12V	12V 输入/输出
	3	GND	地
	4	GND	地
	5	12V	12V 输入/输出
	6	12V	12V 输入/输出

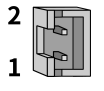
J7 (4PIN/2.0) POE 供电 (直插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	CT1	通信数据 1
	2	CT3	通信数据 3
	3	CT4	通信数据 4
	4	CT5	通信数据 5

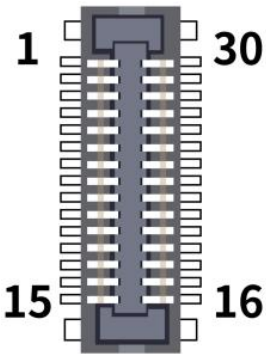
J24 (2PIN/1.25) 4G 喇叭接口(直插)

外观	脚序号	定义	描述
	1	SPKP	4G 通话喇叭正极
	2	SPKN	4G 通话喇叭负极

J25 (2PIN/1.25) 4G MIC(直插)

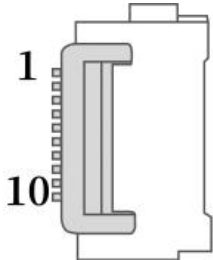
外观	脚序号	定义	描述
	1	MICP	4G MIC 正极
	2	MICN	4G MIC 负极

J18(30PIN/0.5) MIPI-CSI 摄像头接口 (BTB 母座) (背面接口)

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	MIPI_MCLK	MIPI 信号
	3	GND	地
	4	GIF_PDN1	GIF_PDN1
	5	MIPI_RST	复位数据
	6	SDA	IIC 数据
	7	SCL	IIC 时钟
	8	GND	地
	9	VCC_DVP	2.8V 供电
	10	GND	地
	11	VCC	2.8V 供电
	12	GND	地
	13	VCC	1.8V 供电
	14	VCC	1.8V 供电
	15	GND	地
	16	GND	地
	17	MIPI_DON	MIPI 信号

18	MIPI_D0P	MIPI 信号
19	GND	地
20	MIPI_D1N	MIPI 信号
21	MIPI_D1P	MIPI 信号
22	GND	地
23	MIPI_CLKN	MIPI 信号
24	MIPI_CLKP	MIPI 信号
25	GND	地
26	MIPI_D2N	MIPI 信号
27	MIPI_D2P	MIPI 信号
28	GND	地
29	MIPI_D3N	MIPI 信号
30	MIPI_D3P	MIPI 信号

J15（10PIN/FPC座）IIC触摸屏接口（背面接口）

外观	脚序号	定义	描述
	1	GND	地
	2	GND	地
	3	RST	复位数据
	4	INT	中断数据
	5	GND	地
	6	SCL	IIC 时钟
	7	SDA	IIC 数据
	8	VCC	供电
	9	GND	地
	10	GND	地

第四章 电气性能

◆ 标准电源

类别		最小	典型	最大
标准电源参数	电压	11V	12V	13.5V
	纹波	/	/	±3%
	电流	2A	3A	/

◆ 未接其他外设时工作电流

类别		最小	典型	最大
12V 供电电源电流(未接屏等其它外设)	工作电流	/	200mA	400mA
	待机电流	/	10mA	40mA
	电池工作电流	/	0.00098mA	/

◆ USB 供电

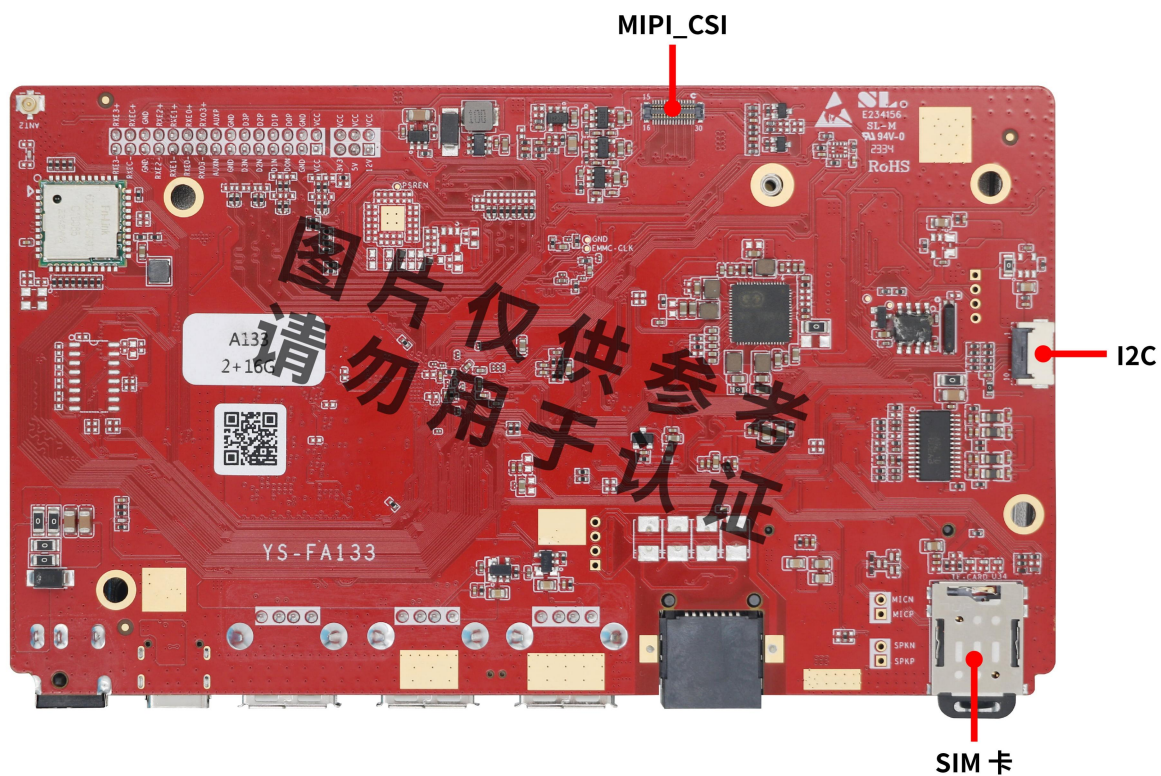
USB 接口	电压	典型电流	最大电流
OTG_USB	5V	500mA	1.5A
HOST_USB	5V	500mA	1.5A

注：USB 外设总电流建议不超过 3000mA，否则会导致机器无法正常运转。

◆ 其他

接口类型	额定电流	最大电流	最大电流
外部 5V 设备总电流	/	3000mA	
外部 3.3V 设备总电流	/	3000mA	
MIPI_DSI 背光	150mA	/	

附录 1 主板背面图



注：此板卡图片仅供参考，由于产品在不断维护，具体出货主板以实物为准

Top view of the YS-FA133 PCB. The board is rectangular with overall dimensions of 146.0mm by 85.0mm. Key features include a central microcontroller (YS-FA133), various peripheral components, and connectors. Dimensions are provided for the board and its components.

Dimensions (mm):

- Overall width: 146.0mm
- Overall height: 85.0mm
- Top edge dimensions: 9.2mm, 112.5mm, 24.3mm
- Left edge dimensions: 13.8mm, 45.9mm, 25.3mm, 4.6mm
- Right edge dimensions: 15.7mm, 54.7mm, 14.7mm, 14.9mm
- Bottom edge dimensions: 10.9mm, 48.0mm, 68.2mm, 78.1mm, 87.5mm, 107.2mm, 123.0mm, 137.6mm, 126.5mm, 146.0mm
- Component dimensions: 6.4mm, 5.0mm, 12.8mm, 1.4mm, 4.7mm, 14.3mm, 8.0mm, 11.0mm, 14.5mm, 0mm, 4.5mm, 14.5mm, 14.5mm, 9.9mm, 7.0mm, 5.6mm, 10.5mm, 7.4mm, 1.6mm

注：各元器件的焊接公差约为 $\pm 0.5\text{mm}$

*PCBA 长度: 146mm *PCBA 宽度: 85mm *PCBA 高度: 12mm *PCBA 螺丝孔直径: 3.4mm x4